

## Камеры термошока жидкостного типа ETSP серия TSL

**Производитель:**

ETSP Co., Ltd

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Камеры термошока жидкость-жидкость ETSP серии TSL предназначены для испытания узлов (как правило, микросхем) на термический удар, подвергая их резким перепадам температур путем попеременного погружения в холодную и горячую ванны с жидкостью.

### Технические характеристики

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Диапазон температур в холодной ванне              | -65 °С...0 °С              |
| Диапазон температур в горячей ванне               | +70 °С...+150 °С           |
| Точность температуры                              | менее $\pm 0,5$ °С         |
| Предварительный нагрев горячей зоны               | +200 °С                    |
| Предварительное охлаждение холодной зоны          | -70 °С                     |
| Скорость нагрева                                  | +200 °С в течении 80 минут |
| Скорость охлаждения                               | -70 °С в течении 90 минут  |
| Время восстановления заданной температуры в ванне | в течении 5 минут          |
| Время перемещения образца между ваннами           | Менее 10 секунд            |